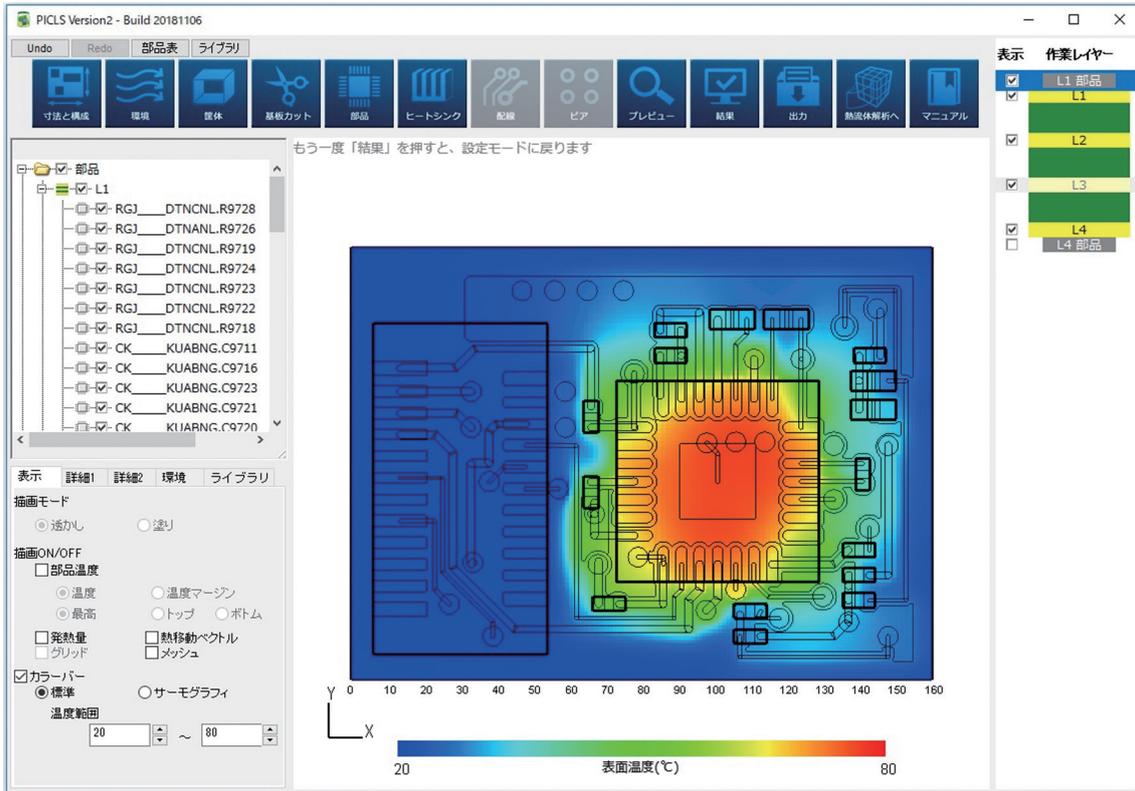


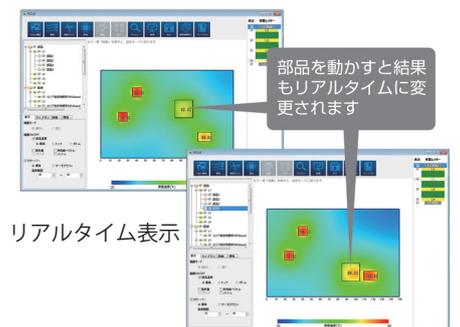
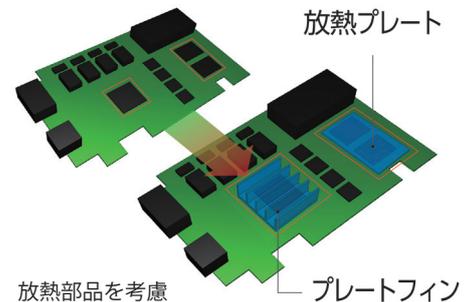
基板設計者が簡単に使える熱解析ツール



製品・技術の名称 基板設計専用熱解析ツール「PICLS(ピクルス)」

【概要】

本製品は、電子基板設計者が製品開発現場で活用する熱解析ツールです。設計者が市販の図形ソフトを使う感覚で設計ができ、熱流体の専門知識がなくても約1秒以内で熱解析の計算結果を出力することができます。従来の熱解析ツールは、熱流体等の専門知識が求められ、解析時間も数時間～数日を要し、価格も高価で、導入は大企業の開発部門などの一部に留まっていた。またユーザから“熱問題の相談中にその場で改善策を提示したい”“操作が簡単なら様々なアイデアをストレスなく試せる”などのリクエストが多く寄せられ、本製品はこうした声に応える製品です。



ここがポイント!

「PICLS」は、熱解析の3つの工程「メッシュ作成」、「乱流モデルの選択」、「解析結果処理」を全て自動化し、かつ約1秒以内の速さで分析結果を表示できるソフトウェア。

【参考価格】

198,000円
※表示価格は税抜きです。

【企業PROFILE】



株式会社ソフトウェアクレイドル
代表取締役社長：久芳 将之

大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号
Tel : 06-6343-5641 / Fax : 06-6343-5580
<https://www.cradle.co.jp/>

企業からの一言 / PR ポイント

「熱流体の知識がいるため手が出し辛い」
「3D操作は抵抗がある」
「もっと早く答えが欲しい」といった設計現場の声を解決すべく開発された製品が「PICLS」です。本製品がものづくりに携わる人々に役立つことを期待しています。